

## 台灣精材 (3467 TT) Forcera

持續拓展先進耗材市場，營運獲利漸入佳境

未評等

收盤價 (2025/03/24) : 75.5

## 交易資料表

市值	NT\$2,115 百萬元
外資持股比率	0.9%
董監事持股比率	41.1%
股價淨值比	16.09倍

## 簡明損益表

年初至12月(千元)	2022	2023	2024
營業收入	651,728	563,365	617,308
營業毛利	106,511	92,117	113,437
營業利益	34,097	18,830	25,806
稅後淨利	47,942	22,176	28,852
EPS (元)	1.80	0.80	1.02
YoY			
營業收入	15.4%	-13.6%	9.6%
營業利益	84.7%	-44.8%	37.0%
稅後淨利	202.8%	-53.7%	30.1%
獲利比率			
毛利率	16.3%	16.4%	18.4%
營業利益率	5.2%	3.3%	4.2%
稅後利益率	7.4%	3.9%	4.7%

陳娟娟

Chuanchuan.Chen@yuanta.com

林采潔

stacylin68@yuanta.com

## 元大觀點

- 台灣精材為少數有能力提供半導體前段精密陶瓷、石英產品之廠商，並規劃往先進製程、後段清洗、封測市場拓展，營運趨勢向上。
- 2025 年半導體景氣復甦，公司近期拓展新客戶及高階材料應用有成，公司營收目標年增雙位數，且毛利率持續改善將帶動獲利向上。
- 中長期先進製程持續推進、自主供應鏈趨勢，推升半導體設備及耗材產業營運展望正向。

## 台灣精材為少數有能力提供半導體等級陶瓷石英耗材之供應商

台灣精材專注於半導體前段製程耗材研發與製造，具備自主精密陶瓷材料的製作、加工表面處理及清洗等一站式整合關鍵技術。公司陶瓷/石英產品營收占比分別為 6-7 成/2-3 成，策略集中於與原廠接軌，專注於為前段製程提供關鍵設備腔室耗材，並持續往先進製程、後段清洗、封測市場拓展。由於半導體耗材認證後不容易被更換，具備先進者優勢，公司已獲得全球最大半導體設備製造商認證，競爭對手包含日本的 Kyocera 和 NTK 等國際大廠。

## 2025 年營收有望年增雙位數，毛利率持續改善帶動獲利向上

2024 年隨著供應鏈存貨調整進入尾聲，整體產業步出低谷，Semi 預估 2024/2025 年前段半導體設備支出年成長 8%/5%，帶動耗材廠商營收重回成長軌道。2024 營收為 6.2 億元，年增 9.6%，毛利率提升 2 個百分點至 18.4%，EPS 1.02 元。隨著營運規模擴大、往先進製程如 N7 以下及 12 吋產品發展，帶動產品組合優化，毛利率已有明顯改善。2025 年隨著半導體景氣復甦、新品圓廠產能開出，且台灣精材已打入全球半導體大廠供應鏈，並持續布局高階、技術難度較高的產品，營運展望正向，公司目標營收年增雙位數，中短期將以毛利率為導向，將持續帶動獲利成長。

## 先進製程持續推進、自主供應鏈趨勢，有利公司營運發展

中長期 AI 應用帶動需求擴展，持續往先進製程推進，前段製程中所應用之陶瓷耗材如 Domes、Rings 消耗量及品質要求將會提高，有利於相關耗材廠商營運成長。根據 Frost & Sullivan，預計 2026 年以前全球泛半導體先進結構陶瓷市場規模將以 CAGR 7% 穩健成長，台灣精材持續拓展新客戶群、研發新材料、開發新產品線，隨著半導體先進製程發展以及各國建立自主供應鏈趨勢，陶瓷/石英等耗材需求有望隨著產業趨勢向上而同步受惠，台灣精材具潛在市占率上漲空間，中長期營運展望正向。

## 全球少數可以提供半導體前段製程精密陶瓷/石英之企業

台灣精材創立於 1997 年，創立之初期即以半導體中所需之高純度耗材零組件為主要業務，其精密陶瓷/石英主要用於半導體前段製程(Front-End)中之蝕刻(Etch)與薄膜(Thin-film)等重要製程。2014 年公司取得美系設備大廠認證後，半導體相關業務持續成長，後續亦陸續擴大經濟規模與經營範疇，成功進入全球半導體設備與晶圓代工之供應鏈。

圖 1：台灣精材股權結構

排序	持股人姓名	持股率 (%)
1	佳龍科技	19.06%
2	富兆投資	11.83%
3	台灣陸地投資	9.85%
4	華立企業	8.35%
5	兆豐銀行	4.30%
6	中國信託受託財產專戶	4.23%
7	怡康投資	4.06%
8	馬堅勇	3.84%
9	堯富精密	2.12%
10	昌蒲實業	2.03%
前十大股東合計		69.65%

資料來源：公司資料、元大投顧

圖 2：台灣精材經營團隊

職稱	姓名	學歷	經歷
董事長	馬堅勇	德國斯圖加特大學 冶金博士	中科院材料光電所組長 探微科技總經理 光洋應材總經理 光洋應材董事長
總經理	王元星	國立政治大學 經營管理研究所	華新麗華股份有限公司 運籌長 固特異輪胎亞太區供應 鏈經理
技術長	蔣天福	國立清華大學 材料科學工程所博士	茂迪(股)公司研發資深經 理 華星光通科技公司製程 經理

資料來源：公司資料、元大投顧

## 半導體等級陶瓷品質直接影響晶圓生產良率，台灣精材以三大核心技術為重要優勢

台灣精材主要從事半導體前段製程用耗材(陶瓷、石英及矽)之製造及買賣，其中應用於半導體製程設備零組件之精密陶瓷零組件多應用在離晶圓相對接近的腔室內，因此必須具備高強度、耐高溫、耐高壓、耐電漿、抗強酸鹼腐蝕、高精度、組織緻密均勻等要求，常見的陶瓷材料有氧化鋁、氧化鋯、氮化矽、碳化矽陶瓷等，在要求精密度非常高之半導體產業中要能精密控制加工工法具有相當難度，而當前台灣精材則以氧化鋁陶瓷材料為主要產品，為台灣少數可以提供半導體等級陶瓷材料之企業。整體而言，台灣精材在半導體等級陶瓷製程具備三大關鍵技術：

- (1) 精密陶瓷材料研發製作技術(Ceramic material processing)：精密陶瓷材料的研發生產必須以材料科學為基礎，從漿料混練、分散、噴霧造粒、生胚成型與加工到最終燒結，每一道製程都必須經過嚴格管控以達成接近零缺陷目標，台灣精材目前生產的兩種高純度氧化鋁陶瓷材料 – Sicalox 99.5%及 FA998 99.7%，都獲得世界第一大半導體設備製造商認證合格，隨著半導體產業往 2/3nm 先進製程發展，台灣精材也提前布局，展開次世代創新陶瓷材料開發工作，次世代創新陶瓷材料將為台灣精材建立全球領先的競爭優勢，創造新商機。

- (2) **精密加工與表面處理技術(Precision machining & surface treatment)**：陶瓷材料燒結後進入加工製程，台灣精材具備多種 CNC 車床、銑床、磨床、噴砂設備、拋光機等精密加工設備完成表面處理。有別於傳統金屬材料，陶瓷皆為硬脆材料，加工難度相對高，稍有不慎在加工後會產生微裂(microcrack)，使得產品上機後成為微粒(**particle**)的來源，直接影響終端用戶的晶圓製造良率，台灣精材的精密加工與表面處理技術通過美系半導體設備製造商認證合格，2021 年開始與國際半導體大廠合作進一步開發零件再生與重建技術(**part refurbishment & repair**)，將使用過的高階陶瓷舊品重新翻修後重複使用，為客戶創造價值，預計未來將成為台灣精材新開發的核心技術，將為公司帶來新商機。
- (3) **清洗技術(Parts clean)**：台灣精材之清洗技術於 2014 年通過世界第一大半導體設備製造商認證合格，交到客戶手中的產品都能達到高潔淨度，確保上機後不會有產生微粒(**particle**)的風險，因應半導體產業逐年往先進製程發展，對於陶瓷/石英產品殘留的 **particle** 數量要求也更趨嚴格，台灣精材採取下列策略佈局，搶占先機：
- A. 結合精密加工/表面處理與清洗蝕刻的技術優勢，針對石英產品開發出遠高於業界水準的 **particle** 控制技術，為進入<5nm 的製程提前布局。
  - B. 與國際半導體大廠共同合作，啟動建置新清洗線的工程，預計於 4Q25 開始陸續完成認證。

圖 3：台灣精材半導體等級陶瓷製程

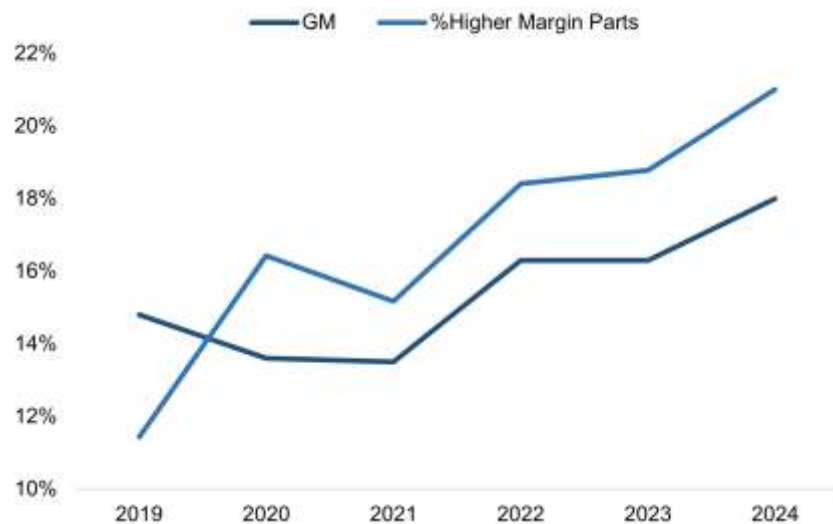


資料來源：公司資料、元大投顧

## 高毛利產品佈局成效漸顯，毛利率持續提升

台灣精材累計至 2024 營收為 6.2 億元，年增 9.6%，毛利率提升 2 個百分點至 18.4%，EPS 1.02 元，年增 27.5%。過往台灣精材為維持稼動率，多生產毛利較低之成熟產品為主，且競爭對手多為國際大廠，因此初期採低價搶單策略，然自 2019 年起台灣精材逐步轉型至生產先進製程及 12 吋較高毛利率產品，相關高毛利產品營收占比已由 2019 年約 10% 提升至當前 21%，毛利率由過往 13-14% 提高至目前 18% 水準。公司近年積極開發新世代材料、新客戶、推動高毛利產品，近期台灣精材已打入全球半導體大廠供應鏈，並持續布局 N5 以下技術能力，中長期隨半導體先進製程持續推進及各國持續建立自主供應鏈，陶瓷/石英等耗材需求有望隨著整體半導體趨勢向上而同步受惠，營運展望正向。

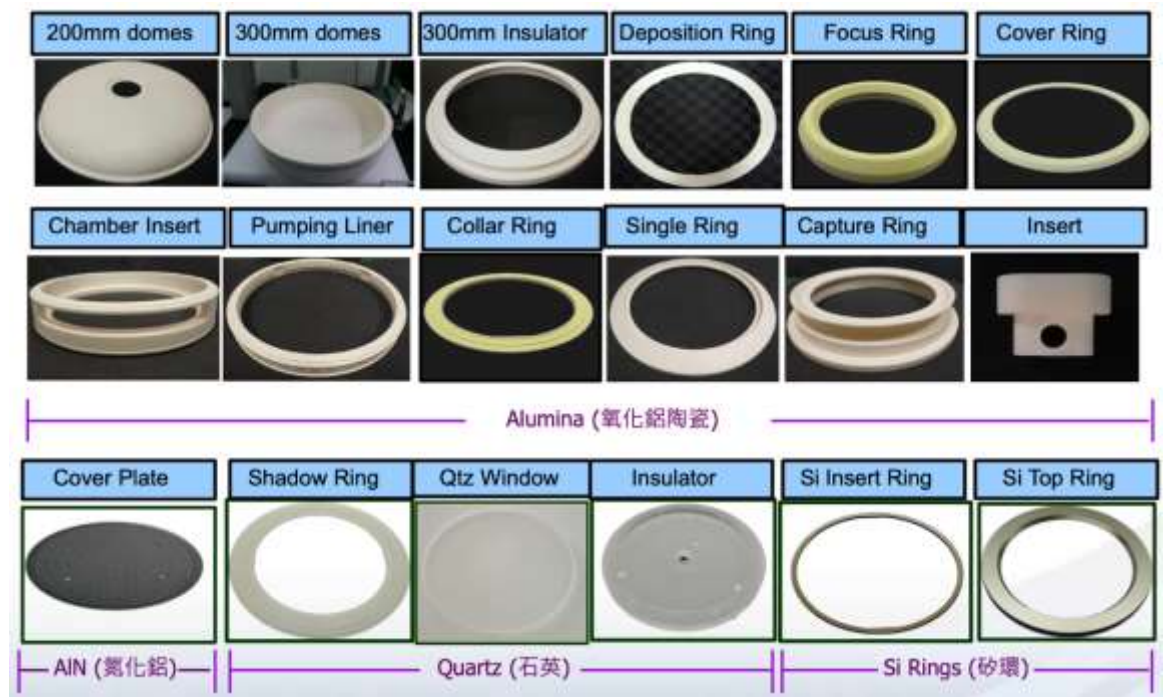
圖 4：台灣精材毛利率及高毛利產品佔比



資料來源：公司資料、元大投顧

當前營收佔比最大之美系設備大廠為台灣精材最早取得認證之國際大廠，近年來公司亦積極與國際半導體大廠共同發展新技術(Technical Collaboration)，當前台灣精材先進陶瓷產品已達到先進製程要求，未來公司將持續針對 7nm 以下高階製程使用的耗材進行優化及開發，同時亦開始著手下世代新材料研發工作。台灣精材的產品廣泛應用於全球各大晶圓代工廠商，皆已取得相關供應耗材之認證或達相關製程要求，顯見公司提供之耗材已具備國際認證之品質。未來公司預計透過四大主線定調成長策略：1) 開發新世代陶瓷材料；2) 持續強化技術縱深，在精密加工及清洗蝕刻之優勢基礎下，開發高階製品的表面處理創新技術；3) 自建高階製程零件清洗產線；4) 陶瓷應用由前段製程橫向擴散到新領域，創造新商機，目標持續提升高毛利產品占比，拉高整體毛利表現。

圖 5：台灣精材產品組合



資料來源：公司資料、元大投顧

圖 6：台灣精材合併綜合損益表

NT\$仟元	2021	2022	2023	2024
營業收入	564,799	651,728	563,365	617,308
營業成本	488,440	545,217	471,248	503,871
營業毛利	76,359	106,511	92,117	113,437
營業費用	57,897	72,414	73,287	87,631
營業利益	18,462	34,097	18,830	25,806
營業外收益及支出	-2,630	8,474	3,674	5,369
稅前淨利	15,832	42,571	22,504	31,175
所得稅費用	0	-5,371	328	2,323
本期淨利	15,832	47,942	22,176	28,852
調整後每股盈餘(元)	0.59	1.8	0.8	1.02

資料來源：公開資訊觀測站、元大投顧



圖 7：台灣精材合併資產負債表

NT\$仟元	2021	2022	2023	2024
流動資產	337,062	343,643	349,775	391,913
現金及約當現金	88,113	102,093	113,990	129,737
應收票據及帳款	70,781	61,946	53,690	57,768
存貨	149,710	154,768	152,882	161,925
非流動資產	338,861	368,750	353,910	332,994
不動產、廠房及設備	331,395	348,813	341,372	295,336
其他非流動資產	7,466	19,937	12,538	37,658
資產總額	675,923	712,393	703,685	724,907
流動負債	197,219	207,227	146,759	165,862
短期借款	0	0	0	0
合約負債 - 流動	0	0	0	0
應付帳款	32,394	26,685	19,135	24,971
其他應付款	108,822	125,818	78,758	90,854
其他流動負債	56,003	54,724	46,881	47,216
非流動負債	120,274	109,346	114,846	105,111
長期借款	119,635	108,715	111,179	100,491
遞延所得稅負債	13	86	80	141
其他非流動負債	0	0	40	40
淨確定福利負債	0	0	0	365
租賃負債 - 非流動	626	545	3,547	4,074
負債總額	317,493	316,573	261,605	270,973
權益	358,430	395,820	442,080	453,934
普通股股本	238,105	238,105	282,066	282,066
資本公積	50,437	51,790	61,224	61,224
保留盈餘	69,888	105,925	98,790	110,644
其他權益	0	0	0	0
負債與權益總額	675,923	712,393	703,685	724,907

資料來源：公開資訊觀測站、元大投顧

圖 8：台灣精材合併現金流量表

NT\$仟元	2021	2022	2023	2024
本期純益	15,832	42,571	22,504	31,175
折舊及攤提	69,460	68,260	71,147	64,551
其他	22,291	21,655	-46,261	-7,383
營運活動之現金流量	107,583	132,486	47,390	88,843
資本支出	-26,251	-90,447	-63,647	-42,854
其他資產變動	-733	-2,073	-339	-1,949
投資活動之現金流量	-26,984	-92,520	-63,986	-44,803
短期借款增加	0	0	0	0
短期借款減少	0	0	0	0
發行現金股利	-5,952	-11,905	0	-16,924
現金增資	0	0	0	0
其他調整數	-24,249	-14,081	28,493	-11,360
融資活動之現金流量	-30,201	-25,986	28,493	-28,284
匯率影響數	0	0	0	0
本期產生現金流量	50,398	13,980	11,897	15,747
自由現金流量	81,332	42,039	-16,257	45,489

資料來源：公開資訊觀測站、元大投顧

### 庫存調整進入尾聲，2025 年全球半導體設備有望重返高峰

2024 年隨半導體庫存調整結束，整體產業逐步走出低谷，預期 2025 年全球晶圓廠設備支出將迎來高峰，年增 5% 達 1,160 億美元，其中投資主要來自 12 吋晶圓廠，投資金額將年增 10% 達 650 億美元，全球晶圓廠產能近一步年增 11%；記憶體投資金額將年減 3% 至 330 億美元，全球產能則年增 3%。

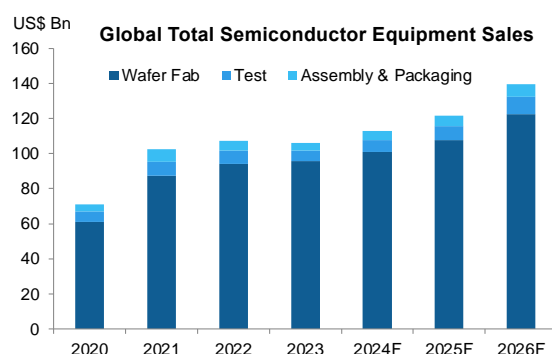
據 SEMI 資料，2023 年全球半導體設備總銷售額衰退 1.4% 至約 1,059 億美元，2024 年重返成長趨勢，設備銷售額年增 7% 達 1,128 億美元，預估 2025/2026 年將分別年增 8%/15% 至 1215/1,394 億美元。晶圓廠設備銷售也將於 2025/2026 年分別年成長 8%/11%。

圖 9：2025 年全球晶圓廠設備支出將年增 5%



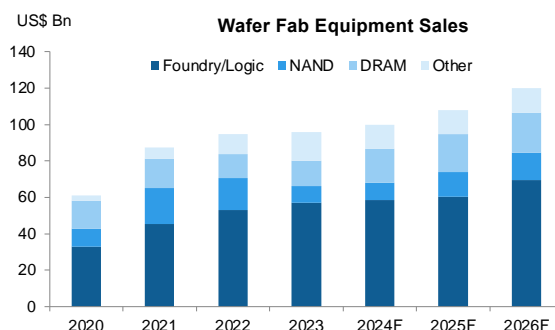
資料來源：SEMI、元大投顧整理

圖 10：2025/26 年半導體設備銷售 YoY +8%/+15%



資料來源：SEMI、元大投顧整理

圖 11：2025/26 年晶圓廠設備銷售 YoY +8%/+11%

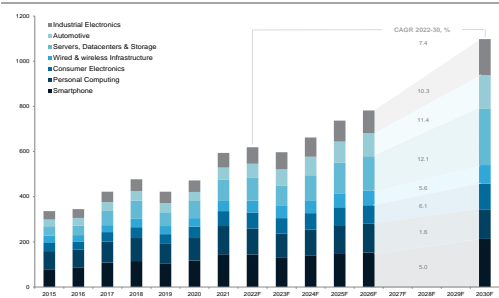


資料來源：SEMI、元大投顧整理

先進製程、供應鏈在地化仍為大勢所趨

近年來，數位轉型帶動 AI、HPC、5G、車用應用趨勢更為成熟，帶動先進製程/封裝相關設備/材料需求強勁，半導體晶圓廠與設備廠多看好先進製程趨勢及創新應用之成長潛力，台積電最新宣布加碼 1,000 億美元在美國投資興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間研發中心，整體在美投資金額高達 1,650 億美元；ASML 亦受惠先進製程演進，2020-2025F 年營收年複合增長率將達 20%，且高階曝光機仍持續供不應求，預期 2025 EUV 出貨目標較目前成長約 80%以上。此外，近年因產能吃緊、地緣政治等因素所造成的晶片斷鏈，已促使世界各國開始重視自主供應鏈之建立，並積極推動補貼政策，盼建立更具彈性之供應鏈。展望中長期，本中心認為先進製程、自主供應鏈將成為推升半導體設備之重要成長動能。

圖 12：2020-30 年半導體終端應用成長概況



資料來源：元大投顧整理

圖 13：各國積極推動補貼政策

國家	研發投資獎勵	租稅優惠	建廠補助
美國	●	●	●
中國	●	●	
歐盟	●		
日本	●		●
韓國	●	●	
印度	●		●
台灣	●	●	

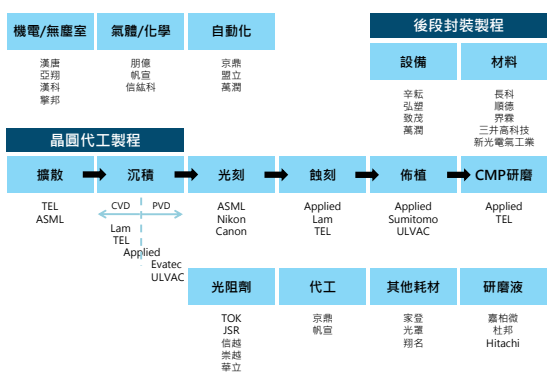
資料來源：MIC、元大投顧

台灣設備供應鏈以廠務、後段設備、代工及代理為切入點

半導體先進製程的前段設備佔資本支出達 8-9 成，且前五大供應商包括 ASML、Applied Materials、Lam Research、TEL、KLA 集中度亦高達 8 成以上，台灣在前段設備著墨較少，主要切入點以代工業務、廠務自動化、後段製程設備、零組件維修及通路業務為主。

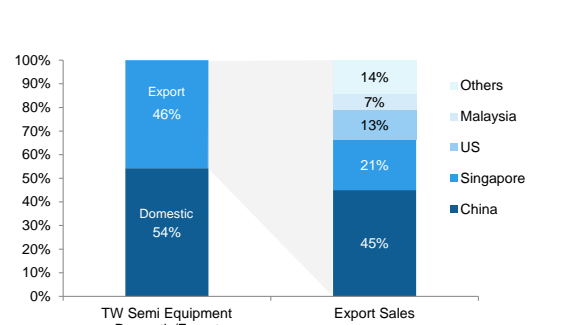
根據台灣電子製造設備工業同業公會，2024 年台灣半導體設備產值有望達 1,532 億元。近年隨國內業者積極投入研發，台灣半導體設備外銷佔比已從 2016 年之 31%提升至目前超越 5 成，可見台灣設備廠商已逐漸打入國際市場。

圖 14：台廠利基點在於廠務、代工、後段濕製程設備



資料來源：元大投顧

圖 15：台灣半導體設備外銷比重占約五成



資料來源：經濟部統計處、元大投顧

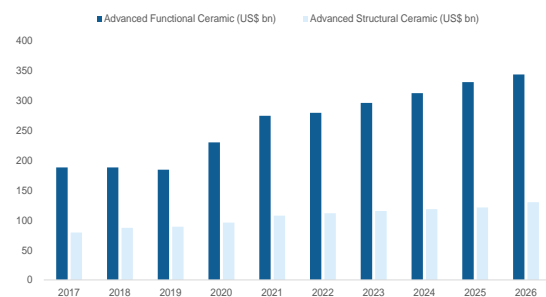


## 2023-2026 年全球泛半導體先進陶瓷市場將以 CAGR 7% 向上成長

陶瓷材料為由陶瓷粉末成型後在高溫作用下硬化而成的製品，具備高強度、高熔點、化學穩定性佳、耐腐蝕、電絕緣性佳等優點，然因其塑變形能力差、硬脆度高，故在加工製程上具備一定程度之挑戰性。目前陶瓷材料可分為普通陶瓷及先進陶瓷兩大領域，先進陶瓷為當今多項科技工藝發展之關鍵零組件，主要可分為氧化物、碳化物、氮化物、其他先進陶瓷材料等，其市場規模占比分別約為 46%、28%、20%、6%，其中氧化物陶瓷(尤其是氧化鋁陶瓷)之應用領域最為廣泛，當前使用規模也最大。若按照用途區分，先進陶瓷可分為具有高強度、高硬度、耐高溫、耐腐蝕、抗氧化等特點的結構陶瓷，以及具有電氣性能、磁性、生物特性、熱敏性和光學特性等特點的功能陶瓷。

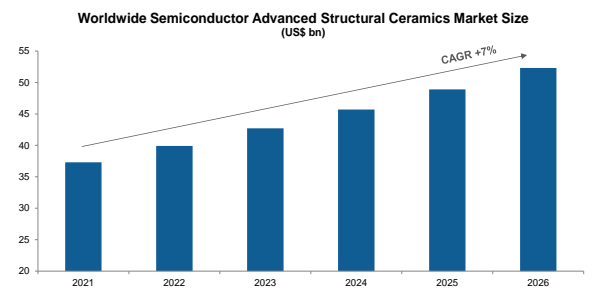
根據 Frost & Sullivan 數據顯示，2021 年全球先進陶瓷市場規模達到 3,910 億元，其中先進結構陶瓷市場規模為 1,120 億元(佔比約 3 成)，先進功能陶瓷市場規模 2,800 億元(佔比約 7 成)，估計 2023-2026 年全球先進陶瓷市場規模的 CAGR 為 5%。而在先進結構陶瓷市場中，泛半導體領域相關應用為重要需求來源，全球泛半導體先進結構陶瓷市場規模(包括新品、零部件更新等需求)約佔全球先進結構陶瓷市場規模約 35%，預計 2023-2026 年全球泛半導體先進結構陶瓷市場規模的 CAGR 為 7%。

圖 16：全球先進陶瓷產業規模



資料來源：Frost & Sullivan、元大投顧整理

圖 17：全球泛半導體先進陶瓷產業規模

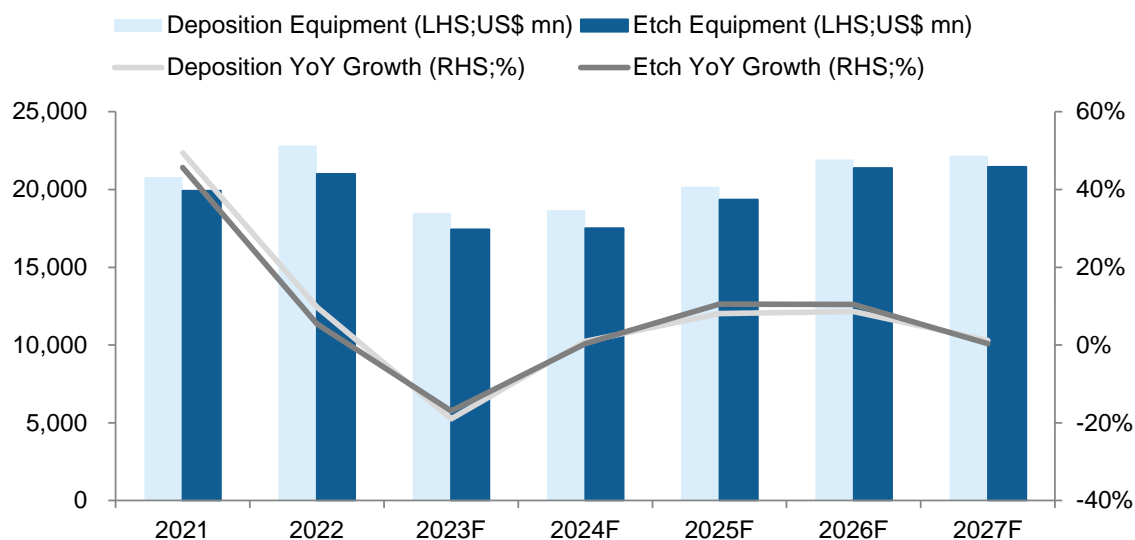


資料來源：Frost & Sullivan、元大投顧整理

## 蝕刻/薄膜沉積設備市場規模大，未來將持續穩健成長

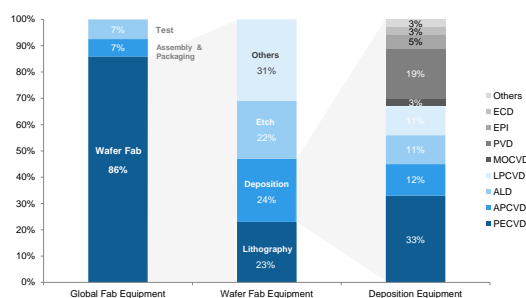
台灣精材所生產之精密陶瓷/石英主要用於半導體前段製程中之蝕刻與薄膜沉積兩大重要製程中，目前晶圓廠對於薄膜沉積/蝕刻設備之投資占比分別約為 24%/22%。展望未來，隨著未來積體電路製造不斷向更先進工藝發展，晶片結構複雜度也不斷提高，所需之薄膜層數、薄膜品種隨之增加，先進製程所需之蝕刻道數亦顯著提升，蝕刻/薄膜沉積將成為製程微縮之關鍵設備，未來市場對於高性能蝕刻/薄膜沉積設備的依賴亦將逐漸增加。目前全球薄膜沉積設備市場主要由應用材料、泛林半導體、東京威力科創和先藝科等國際同業佔有。而針對蝕刻設備，目前全球蝕刻設備則主要由 Lam Research、TEL、Applied Materials 三家佔據領先地位，市場份額合計佔比近 9 成。台灣精材在全球蝕刻/薄膜沉積設備廠商布局完備，未來隨相關設備市場持續擴大，其製程所會用到之陶瓷/石英耗材需求亦會持續提高，公司有望長期受惠半導體產業發展趨勢。

圖 18：薄膜沉積/蝕刻設備市場規模



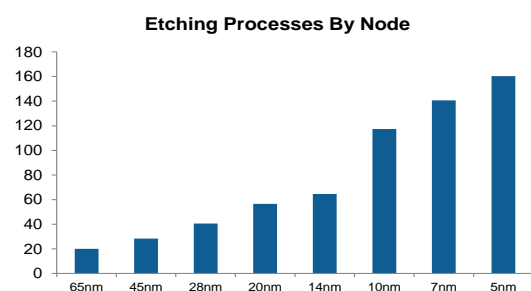
資料來源：元大投顧預估

圖 19：各類薄膜沉積設備占比



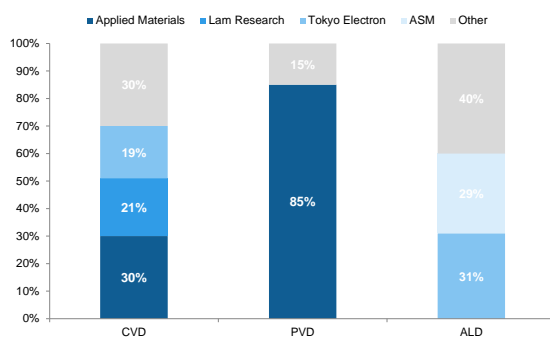
資料來源：SEMI、元大投顧整理

圖 20：各製程所需之蝕刻道數



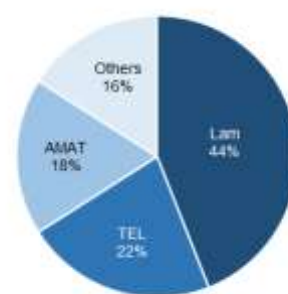
資料來源：元大投顧整理

圖 21：全球薄膜沉積設備市佔概況



資料來源：元大投顧整理

圖 22：全球蝕刻設備市佔概況



資料來源：元大投顧整理

## 附錄：重要揭露事項

### 分析師聲明

主要負責撰寫本研究報告全文或部分內容之分析師，茲針對本報告所載證券或證券發行機構，於此聲明：(1) 文中所述觀點皆準確反映其個人對各證券或證券發行機構之看法；(2) 研究部分分析師於本研究報告中所提出之特定投資建議或觀點，與其過去、現在、未來薪酬的任何部份皆無直接或間接關聯。

### 投資評等說明

買進：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持正面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中增持該股。

持有-超越同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力高於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

持有-落後同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力低於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

賣出：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持負面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中減持該股。

評估中：本中心之預估、評等、目標價尚在評估中，但仍積極追蹤該個股。

限制評等：為遵循相關法令規章及/或元大之政策，暫不給予評等及目標價。

註：元大給予個股之目標價係依 12 個月投資期間計算。大中華探索系列報告並無正式之 12 個月目標價，其投資建議乃根據分析師報告中之指定期間分析而得。

### 總聲明

© 2025 元大版權所有。本報告之內容取材自本公司認可之資料來源，但並不保證其完整性或正確性。報告內容並非任何證券之銷售要約或邀購。報告中所有的意見及預估，皆基於本公司於特定日期所做之判斷，如有變更恕不另行通知。

本報告僅提供一般資訊，文中所載資訊或任何意見，並不構成任何買賣證券或其他投資標的之要約或要約之引誘。報告資料之刊發僅供客戶一般傳閱用途，並非意欲提供專屬之投資建議，亦無考慮任何可能收取本報告之人士的個別財務狀況與目標。對於投資本報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身而諮詢財務顧問的意見。本報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為於該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。

元大研究報告於美國僅發送予美國主要投資法人（依據 1934 年《證券交易法》15a-6 號規則及其修正條文與美國證券交易委員會詮釋定義）。美國投資人若欲進行與本報告所載證券相關之交易，皆必須透過依照 1934 年《證券交易法》第 15 條及其修正條文登記註冊之券商為之。元大研究報告在台灣由元大證券投資顧問股份有限公司發佈，在香港則由元大證券(香港)有限公司發佈。元大證券(香港)係獲香港證券及期貨事務監察委員會核准註冊之券商，並獲許從事受規管活動，包括第 4 類規管活動（就證券提供意見）。非經元大證券(香港)有限公司書面明示同意，本研究報告全文或部份，不得以任何形式或方式轉載、轉寄或揭露。

欲取得任何本報告所載證券詳細資料之台灣人士，應透過下列方式聯絡元大證券投資顧問股份有限公司：

致：聯絡人姓名

元大證券投資顧問股份有限公司

台灣臺北市 106 仁愛路三段 157 號 4 樓